

Sputter-Targets

Sputter-Targets werden gießtechnisch oder pulvermetallurgisch hergestellt. Die Targetgeometrie wird nach Spezifikation des Kunden gefertigt. Die maximale Größe reicht bis zu einem Durchmesser von 10 Zoll. Folgende Elemente werden standardmäßig zu Targets verarbeitet (in Klammern die höchstmögliche Reinheit):

Aluminium (6N)	Antimony (5N)	Bismuth (5N)	Cadmium (5N)
Chromium (5N)	Cobalt (4N)	Copper (5N)	Dysprosium (3N5)
Gadolinium (4N)	Germanium (6N)	Gold (5N)	Hafnium (4N excl. Zr)
Holmium (3N5)	Indium (6N)	Iridium (4N)	Iron (4N)
Lead (5N)	Lithium (2N8)	Magnesium (5N)	Nickel (4N)
Niobium (4N)	Palladium (5N)	Platinum (4N)	Rhenium (4N)
Rhodium (4N)	Ruthenium (4N)	Silicon (5N)	Silver (5N)
Tantalum (4N)	Tellurium (6N)	Tin (6N)	Titanium (4N)
Tungsten (5N)	Vanadium (4N)	Yttrium (3N5)	Zinc (6N)
Zirconium (4N excl. Hf)			

Targets aus Legierungen, Oxiden, Carbiden, Nitriden, Fluoriden und anderen Verbindungen obiger Elemente stehen ebenfalls zur Verfügung. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot nach Ihrer Spezifikation mit der von Ihnen gewünschten Zusammensetzung, Reinheit, Abmessung, Geometrie, etc.